



2026年7月9日

各 位

会 社 名 岡本硝子株式会社
代表者名 代表取締役会長兼 CEO 岡本 毅
(コード番号 7746 東証スタンダード)
問合せ先 財務経理部長 風間 卓
電 話 04-7137-3111

TECHNO-FRONTIER 2026 に株式会社 U-MAP と共同出展します

弊社ではこのたび、7月15日(水)～17日(金)に東京ビッグサイトで開催される「TECHNO-FRONTIER 2026」に株式会社 U-MAP と共同出展いたします。

協業製品である【セラミックス繊維入り高強度 AlN 基板】をはじめ、その他 U-MAP 社の高性能放熱シートなどの放熱製品を展示いたします。

セラミックス繊維入り高強度 AlN 基板は微細な穴開け加工をしたものを展示いたします。

製品サンプルを実際にご覧になれる機会となりますので、ぜひ当社ブース[3-F21]へご来場ください。

◆「TECHNO-FRONTIER 2026」 概要◆

- 【会期】 2026年7月15日(水)～17日(金) 9:30 - 17:00
- 【会場】 東京ビッグサイト 西展示棟
- 【ブース No.】 3-F21
- 【入場料】 無料 ※展示会公式サイトより事前登録が必要です
- 【公式サイト】 <https://www.jma.or.jp/tf/>

◆セミナー情報◆

世界唯一の繊維状 AlN 単結晶ファイラー「Thermalnite®(サーマルナイト)」が切り拓く次世代放熱材料設計
- ハイブリッドファイラーによる熱伝導・実装性・信頼性の最適化アプローチ -

- 【日時】 2026年7月16日(木)11:00～11:50
- 【場所】 出展社セミナー(3)
- 【登壇者】 西谷健治(株式会社 U-MAP 代表取締役)
- 【事前登録 URL】 https://www.jma-exhibition.com/joint/jp_tf/registration_seminar.php

以上

高強度 AlN 基板

AlN 史上最高の機械的強度!

セラミックス製品



サイズ	□4.5inch
厚み	0.2~1.0mm
熱伝導率	170・200W/m・K 230W/m・K(開発中)

特長

高い
熱伝導率

高い
機械的強度

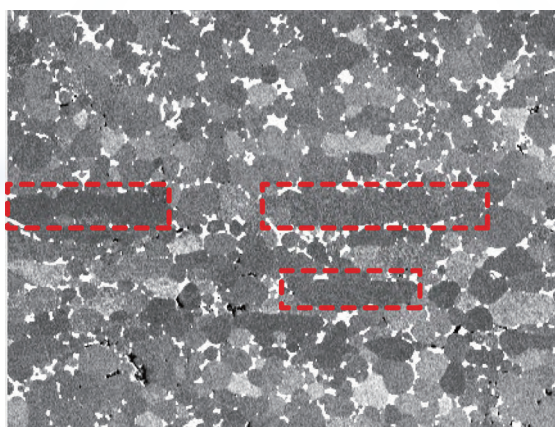
破壊靱性値:
従来比2倍

メリット

01 放熱性向上により
高出力化、小型化が可能

02 マイクロクラックの抑制

〈Thermalnite®による繊維補強〉



用途

- ・LED/LDモジュール【ヘッドライト、殺菌用LED、通信用光トランシーバーなど】
- ・パワーモジュール【車載インバーター、電鉄モーター駆動、工作機械、太陽光/風力発電、無停電電源(UPS)】

高強度AIN基板

◆サイズ：□4.5inch ◆厚み：0.2~1.0mm

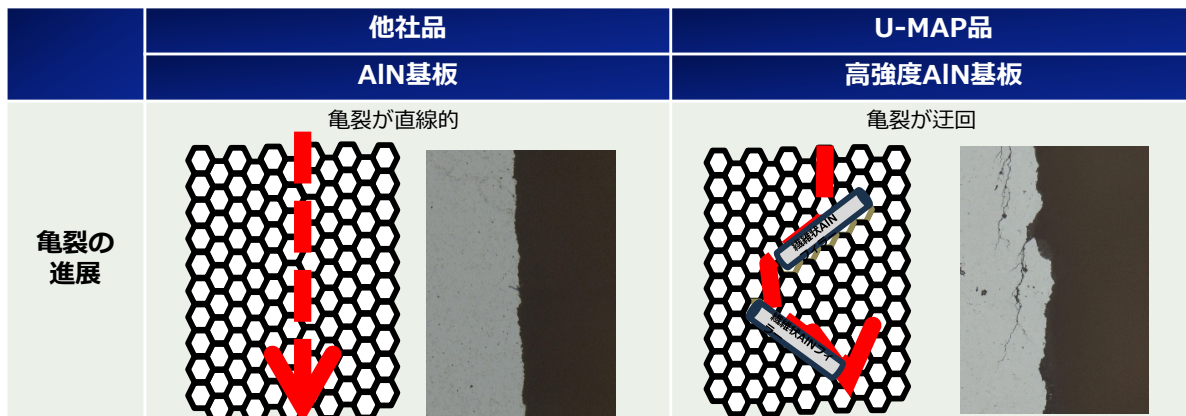


◆特性

特性	測定方法	単位	AIN基板 (他社品)	170W仕様			200W仕様		230W仕様
				標準品	曲げ強度 向上品	0.1mm 薄板達成品	標準品	曲げ強度 向上品	曲げ強度 向上品
熱伝導率	レーザーフラッシュ法	W/m・k	180	170	170	170	200	200	225
密度	アルキメデス法	g/cm ³	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
平面度	三次元測定機 (5×5点)	%	-	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
熱膨張係数	TMA法 (40-300°C)	×10 ⁻⁶	5.2	3.92	X方向:3.81 Y方向:4.28	X方向:3.81 Y方向:4.28	3.92	X方向:3.81 Y方向:4.28	X方向:3.81 Y方向:4.28
曲げ強度	3点曲げ	MPa	350	370	455 X方向530 Y方向380	465 X方向520 Y方向410	280	375 X方向420 Y方向330	330 X方向363、Y方向:300
破断靱性	SEPB法	MPa√m	3.0	6.0	5.3 X方向6.2 Y方向:4.4	5.3 X方向6.2 Y方向:4.4	6.0	5.3 X方向6.2 Y方向:4.4	5.3 X方向6.2、Y方向:4.4

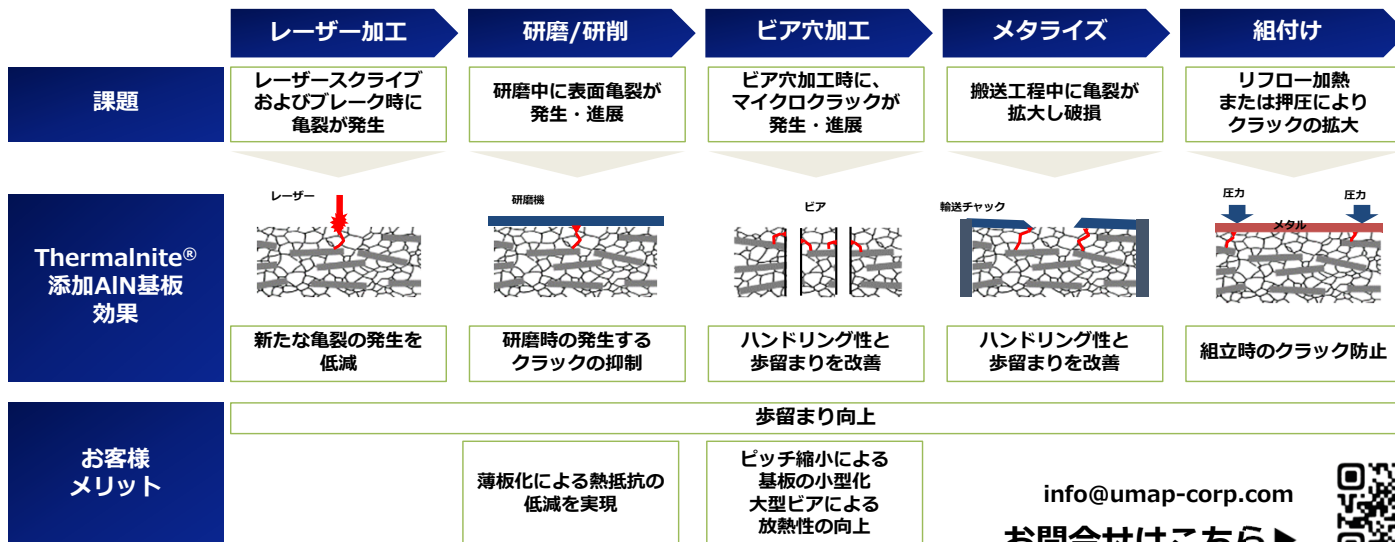
※表中の測定値は実測値であり製品規格値ではありません。

◆機械的強度向上のメカニズム



繊維状AINファイラーによりディフレクションを発現、破壊エネルギーが増大により破壊靱性が向上

◆各工程によるマイクロクラックの進展を抑制



info@umap-corp.com

お問い合わせはこちら▶

